

請求の範囲

- [請求項1] エポキシ樹脂（A）、エポキシ樹脂硬化剤（B）、及びフェノキシ樹脂（C）を含有し、前記エポキシ樹脂硬化剤（B）が下記（1）及び（2）を満たす透明接着剤用組成物。
- （1）粉体状であり累積分布頻度90%時の粒径（ d_{90} ）が2.0 μm 以下
- （2）25℃においてメチルエチルケトン100gに対する溶解度が0.1g以下
- [請求項2] シリカ充填材（D1）を含有し、前記シリカ充填材（D1）が、下記（3）及び（4）を満たし、前記エポキシ樹脂（A）、前記エポキシ樹脂硬化剤（B）、前記フェノキシ樹脂（C）及び前記シリカ充填材（D1）の各含有量の合計に占める前記シリカ充填材（D1）の含有量の割合が、10～50質量%である請求項1に記載の透明接着剤用組成物。
- （3）平均粒径（ d_{50} ）が0.01～0.3 μm
- （4）累積分布頻度90%時の粒径（ d_{90} ）が1.0 μm 以下
- [請求項3] 前記エポキシ樹脂硬化剤（B）が、ジシアンジアミド化合物、イミダゾール化合物、又はヒドラジド化合物を含有する、請求項1又は2に記載の透明接着剤用組成物。
- [請求項4] 前記エポキシ樹脂（A）100質量部に対する前記エポキシ樹脂硬化剤（B）の含有量が4～20質量部である、請求項1～3のいずれか1項に記載の透明接着剤用組成物。
- [請求項5] 請求項1～4のいずれか1項に記載の透明接着剤用組成物を成膜してなるフィルム状透明接着剤。
- [請求項6] 前記フィルム状透明接着剤の熱硬化後のヘーズ値が50%以下である請求項5に記載のフィルム状透明接着剤。
- [請求項7] 熱硬化前の前記フィルム状透明接着剤を25℃から5℃/分の昇温速度で昇温したとき、120℃における溶融粘度が100～1000

0 Pa・s の範囲に達する請求項 5 又は 6 に記載のフィルム状透明接着剤。

[請求項 8] 厚みが 1 ～ 100 μm である請求項 5 ～ 7 のいずれか 1 項に記載のフィルム状透明接着剤。

[請求項 9] 請求項 5 ～ 8 のいずれか 1 項に記載のフィルム状透明接着剤を被着部材上に熱圧着し、該フィルム状透明接着剤を熱硬化させることを含む、透明接着剤硬化層付部材の製造方法。

[請求項 10] 電子部品の製造方法であって、
ウェハの一面に、請求項 5 ～ 8 のいずれか 1 項に記載のフィルム状透明接着剤を熱圧着し、該フィルム状透明接着剤を介してダイシングテープを設ける第 1 の工程と、

前記ウェハと前記フィルム状透明接着剤とを一体にダイシングすることにより、ダイシングテープ上に、透明接着剤層付きウェハチップを得る第 2 の工程と、

前記透明接着剤層から前記ダイシングテープを取り除き、前記透明接着剤層付きウェハチップと他の部材とを前記透明接着剤層を介して熱圧着する第 3 の工程と、

前記透明接着剤層を熱硬化する第 4 の工程と、
を含む電子部品の製造方法。

[請求項 11] ウェハチップと配線基板間、及び／又は、ウェハチップ間が、請求項 5 ～ 8 のいずれか 1 項に記載のフィルム状透明接着剤の熱硬化体により接着されてなる、電子部品。